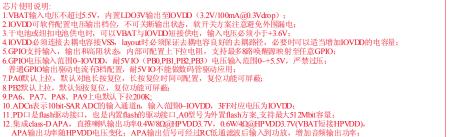
版本更新说明		
版本号	更新日期	更新点:
V1.0	2023.0713	原始版本
V1.1	2023.09.05	更新芯片使用说明

- 1.元器件物料必须保证质量,电容耐压值应大于最大工作电压一倍以上; 2.锂电方案必须带锂保,如果电池不带锂保,硬件设计需添加过流过放电路。
- 3.外露接口和后焊物料: 电池,喇叭等,做好静电和浪涌保护措施,整机ESD应符合最低标准,接触±4K,空气±8K。

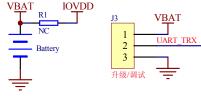


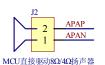
13.APAP, APAN可做IO输出,Ron<IΩ@HPVDD3.7V, 休眠时不可输出,输出态会导致休眠功耗增加;

14.红外接收管信号IRDA, SPI, IIC, UART, MCPWM支持映射到任意PAn和PBn CPIO:

15.开发升级或使用IT8量产的必要测试点: VBAT, GND, PBI串口升级;

APAP与APAN输出电流总和小于400mA(即HPVDD电流小于400mA), 硬件设计时, 禁止超出电流限制;





LED 28 APAN PB3(VPP) APAN 27 APAP IR PB2(VPP)/MCLR/(pu) APAP 26 VBAT UART TRX 3 C5 NC PB1(VPP)/Update **HPVDD** C5 NC C2 105 C1 105/475 HKEY6 4 25 VBAT PB0(VPP) **VBAT** HKEY5 5 24 IOVDD PA12/ADC12 **IOVDD** HKEY4 6 23 GND PA11/ADC11 **VSS** 7 22 VKEY0 HKEY3 PA10/ADC10 (pu)/Reset/ADC0/PA0 21 VKEYI HKEY2 PA9/ADC9/(pd) ADC1/PA1 HKEY1 20 VKEY2 PA8/ADC8/SPI1DI/(pd) ADC2/PA2 HKEY0 19 VKEY3 PA7/ADC7/SPI1DO/(pd) ADC3/PA3 18 VKEY4 VKEY6 11 PA6/ADC6/SPI1CLK/(pd) ADC4/PA4 SPI CS 12 17 VKEY5 PD2/SFCCS ADC5/PA5 13 SPI\_DI 16 SPI DO PD3/SFCDI SFCDO/PD1 FSPG 14 15 SPI CLK FSPG/(pd) SFCCLK/PD0 AD177A0 QSOP28

AD177A0需要外挂flash, pin12/13/14/15/16分别是PD2/PD3/FSPG/PD0/PD1

IR GND IR **IOVDD** 

红外、LED

**FSPG** C4 104 VCC 2 SO/D1 HOLD/D3 3 FSPG SPL CLK  $\overline{\text{WP}}/\text{D2}$ SCK 4 SPI DO **GND** SI/D0 25Qxx 2bit模式spi 外挂flash



## 矩阵按键扫描注意事项:

- 1、所有行扫描按键H-KEY用普通的IO端口即可
- 2、所有列扫描按键V-KEY要求用AD功能的IO端口



